

深圳miniCOB和SMD封装对比

产品名称	深圳miniCOB和SMD封装对比
公司名称	深圳市康普信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3
联系电话	0755-21038002 18565839923

产品详情

现阶段COB(板里处理芯片)封装形式，直接把LED裸集成电路芯片到模块基钢板上，随后进行全面的模封，相对于传统的SMD封装形式。这类COB封装形式的精彩LED模块具备生产制造生产流程少、封装形式成本低、封装形式处理速度快、显示器的可靠性好和屏幕清晰度匀称细致等优点，跻身将来密度高的LED显示屏模组的一种重要的封装类型。现阶段因为COB的全产业链都还没建立和完善下去，COB商品利用系数的费用比SMD高，未来随着COB表明封装形式全产业链逐渐成熟，COB表明封装形式市场占有率将快速升级。在Mini LED运用中，COB封装形式具有更高的稳定性和可靠性，比较容易完成超小间距表明，与Mini LED的技术趋势一致，因而，COB封装形式都是Mini LED的技术趋势之一。